



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20050928000A

2010 年 3 月 3 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタマドキュメント

マネージャ 牧 達郎 SOICパッケージ 一部製品 リードフレーム供給業者追加のご案内(認定済 100 製品への追加認定 2 製品の連絡)

(初版 PCN20050928000 2005 年 10 月 11 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☐ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について認定済 100 製品への追加認定 2 製品の連絡になります。 SOIC パッケージ 一部製品 リードフレーム供給業者追加 現行：EPD 社 変更後：EPD 社、Sumitomo 社	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	追加認定品は 9 月中旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 2006 年 1 月上旬の出荷より実施しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済100製品への追加認定2製品の連絡になります。弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SOICパッケージ 一部製品について、現行 EPD社製 NiPdAu リードフレームを使用して製造していますが、EPD社におけるNiPdAu リードフレーム製造終了の為に、これに替わり、Sumitomo社製NiPdAu リードフレームに変更し認定しました。リードフレームの規格、ベース成分、メッキ仕様に変更はありません。Sumitomo社は、2003年より弊社において使用している半導体業界リードフレーム供給業者トップの中の1社になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

リードフレーム供給業者

現行

EPD社

変更後

EPD社

Sumitomo社

理由：EPD社におけるNiPdAu リードフレーム製造終了の為

対象製品リスト

対象製品名				
■: 追加認定品 □: 認定終了品				
SN105085DR	SN65HVD1176DR	SN65HVD232DR	SN75HVD07D	THS60421D
SN105086DR	SN65HVD11D	SN65HVD233D	SN75HVD07DR	THS60521D
SN65HVD05D	SN65HVD11DR	SN65HVD233DG4	SN75HVD08D	THS6092CD
SN65HVD05DR	SN65HVD11DRG4	SN65HVD233DR	SN75HVD08DR	THS60921D
SN65HVD05DRG4	SN65HVD11QD	SN65HVD234D	SN75HVD10D	THS60921DG4
SN65HVD06D	SN65HVD12D	SN65HVD234DR	SN75HVD10DG4	THS60921DR
SN65HVD06DR	SN65HVD12DG4	SN65HVD235D	SN75HVD10DR	TPS2014D
SN65HVD07D	SN65HVD12DR	SN65HVD23D	SN75HVD1176D	TPS2014DG4
SN65HVD07DR	SN65HVD20D	SN65HVD24D	SN75HVD11D	TPS2014DR
SN65HVD07DRG4	SN65HVD20DR	SN65HVD251D	SN75HVD11DG4	TPS2014DRG4
SN65HVD08D	SN65HVD21D	SN65HVD251DG4	SN75HVD11DR	TPS2015D
SN65HVD08DR	SN65HVD21DR	SN65HVD251DR	SN75HVD12D	TPS2015DR
SN65HVD08DRG4	SN65HVD22D	SN65HVD251DRG4	SN75HVD12DR	TPS62100D
SN65HVD10D	SN65HVD22DR	SN65LBC182D	SN75LBC182D	TPS62100DR
SN65HVD10DG4	SN65HVD230D	SN65LBC182DR	SN75LBC182DR	TPS62101D
SN65HVD10DR	SN65HVD230DG4	SN65LBC182DRG4	SN75LBC184D	TPS62102D
SN65HVD10DRG4	SN65HVD230DR	SN65LBC184D	SN75LBC184DR	TPS62103D
SN65HVD10QD	SN65HVD230DRG4	SN65LBC184DR	THS31121D	V62/06629-01XE
SN65HVD10QDR	SN65HVD230MDREP	SN65LBC184DRG4	THS3122CD	
SN65HVD1176D	SN65HVD231D	SN75HVD05D	THS31221D	
SN65HVD1176DG4	SN65HVD232D	SN75HVD06D	THS6042CD	

注記：初版に記載されていなかった末尾 G4 付製品が一部追加されておりますが、初版発行時(2005年)以降、鉛フリー化対応過渡期に使用された発注製品名の名残で、本第二版追加変更の対象とはなりませんので、対象製品リストには、そのまま記載し特に注記を付けておりません。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2005 年 9 月 23 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN74LVC14AD	Die Rev/Size(mils):	K/38 x 31	
Wafer Fab Site:	TID	Fab Process:	50C29.1	
Technology:	CMOS	Metal1:	TiW/AlCu2	
Passivation:	10k A CN	-	-	
Assembly Site:	TIM	Package Code/Pins:	D/14	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	SUM EME5050RL	
Bond:	TS-0.95 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Leadframe:	4068283-0003	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C,240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C,1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Solderability	8 Hrs Steam Age	22/0	22/0	22/0
Solderability	No Steam Age	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	-	15/0	15/0	15/0
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Lead Integrity	-	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	5/0	5/0	5/0
Salt Atmos	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC, L2/250C	12/0	12/0	12/0
Die Shear	-	12/0	12/0	12/0
Wire Pull	# wires, min. 3.0g	76/0	76/0	76/0
Ball Shear	# balls, min. 4.0g/mil2	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level 2/250C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2005年9月23日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS2226DB	Die Rev/Size(mils):	B/80 x 86	
Wafer Fab Site:	DLN	Fab Process:	LinBiCMOS-4	
Technology:	LinBiCMOS	Metal1-3:	Al(pure)	
Passivation:	10k A CN		-	-
Assembly Site:	TIM	Package Code/Pins:	DB/30	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	SUM EME5050RL	
Bond:	TS-2.0 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Leadframe:	4080485-0003		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Solderability	8 Hrs Steam Age	22/0	22/0	22/0
Solderability	No Steam Age	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	-	15/0	15/0	15/0
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Lead Integrity	-	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	5/0	5/0	5/0
Salt Atmos	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC, L2/260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level 2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2005 年 9 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN74ACT16863DL	Die Size(mils):	124 x 234	
Wafer Fab Site:	SFAB	Fab Process:	EPIC-1ZS	
Technology:	CMOS	Metal1-2:	TiW/AICu2	
Passivation:	10k A CN	-	-	
Assembly Site:	TIM	Package Code/Pins:	DL/56	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	DEX MG52F-08	
Bond:	TS-0.95 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Leadframe:	4204089-0001	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Solderability	8 Hrs Steam Age	22/0	22/0	22/0
Solderability	No Steam Age	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC, L1/235C	12/0	12/0	12/0
Die Shear	-	12/0	12/0	12/0
Wire Pull	# wires, min. 3.0g	76/0	76/0	76/0
Ball Shear	# balls, min. 4.0g/mil2	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level 1/235C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2005 年 9 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	QTPIC2603DW	Die Size(mils):	115 x 139	
Wafer Fab Site:	F	Wafer Fab Site:	F	
Assembly Site:	TITL	Package Code/Pins:	DW/24	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	DEX HYSOL 9AS	
Bond:	TS-0.95 Au	L/F Finish:	NiPdAu	
Leadframe:	4073884-0004	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC, L1/220C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level 1/220C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2005 年 9 月 23 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	SN102928NE	Die Size(mils):	120 x 137	
Wafer Fab Site:	SFAB	Fab Process:	J1 Bipolar	
Technology:	Bipolar	Metal1:	TiW/AICu2	
Passivation:	10k A CN	-	-	
Assembly Site:	TIM	Package Code/Pins:	NE /16	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	HYSOL 9AS	
Bond:	TS-1.3 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Leadframe:	4044519-0003	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Salt Atmos	-	22/0	22/0	22/0
Die Shear	-	12/0	12/0	12/0
Wire Pull	# wires, min. 3.0g	76/0	76/0	76/0
Ball Shear	# balls, min. 4.0g/mil2	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, TI pin-through-hole preconditioning				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2005 年 9 月 23 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	CCBT3306PW	Die Size(mils):	E/28 x 26	
Wafer Fab Site:	TID	Fab Process:	EPIC-1ZS	
Technology:	CMOS	Metal1-2:	TiW/AICu2	
Passivation:	10k A CN	-	-	
Assembly Site:	TIM	Package Code/Pins:	PW/8	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	Mold Compound:	KMC-288P3	
Bond:	TS-0.8 Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
Leadframe:	4068306-0003	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
Solderability	8 Hrs Steam Age	22/0	22/0	22/0
Solderability	No Steam Age	22/0	22/0	22/0
Lead Finish Adhesion	-	15/0	15/0	15/0
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Lead Integrity	-	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	5/0	5/0	5/0
Salt Atmos	-	22/0	22/0	22/0
Moisture Sensitivity	JEDEC, L2/250C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level 2 / 250C				